

证券代码：002371

证券简称：北方华创

北方华创科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年5月15日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、执行委员会主席 赵晋荣 副董事长 陶海虹 董事、执行委员会副主席 纪安宽 董事、执行委员会副主席、总裁 董博宇 执行委员会委员、首席财务官 李延辉 执行委员会委员、董事会秘书 王晓宁 独立董事 张大成

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1.公司如何看待出海前景？有无观察到海外设备厂出货周期拉长，海外晶圆厂采购国内设备的现象？</p> <p>答：您好，公司积极推进国际化发展战略。公司将持续关注海外市场需求变化，不断提升产品竞争力，稳步推进国际化业务。感谢关注！</p> <p>2.Q1：考虑当前的市场需求，公司目前如何展望2026年的订单规模和增速？ Q2：公司如何看待2026-27年中国半导体设备支出增速相较于2025年的变化？主要驱动因素有哪些？各个细分领域的增速分别如何？ Q3：新建产线的设备国产化率目前大致处于什么水平？在先进逻辑、成熟制程和存储领域之间有何差异？ Q4：在当前存储和先进逻辑客户支出周期下，未来三年蚀刻和沉积设备需求的比较合理增长区间应是多少？北方华创的增长与行业平均水平相比会有什么区别？ Q5：公司如何展望今年的毛利率和净利率的水平？我们长期的目标毛利率和净利率是多少？主要核心驱动因素有哪些？</p> <p>Q6：我们应该如何展望2026和27年研发投入占收入的比例？接下来的研发投入主要会集中在哪些领域？ Q7：市场反馈CCP设备定价通常较中微低10-15%，公司是否考虑通过更积极的价格或促销策略来获取新老品类的市场份额？定价环境和产品结构变化将如何影响蚀刻和沉积设备的毛利？</p> <p>答：Q1：您好，从目前行业景气度和客户端资本开支规划来看，2026年国内逻辑、存储、先进封装等领域需求保持旺盛。公司对2026年整体订单规模保持乐观。感谢关注。</p> <p>Q2：您好，2026-2027年国内半导体设备整体资本开支仍会维持高位，整体处在景气扩张区间。核心驱动主要来自两大主线：一是下游新兴应用需求爆发，AI算力芯片、HBM及先进存储等领域产能扩建需求旺盛；二是国产化替代加速推进，国产设备的验证广度和导入深度均显著加快。从细分领域增速来看，存储、先进逻辑和先进封装均保持快速增长；成熟逻辑、功率及特色工艺领域设备需求保持稳健。感谢关注。</p> <p>Q3：您好，国内各地新建晶圆产线整体设备国产化率持续抬升。逻辑、存储、功率、特色工艺产线国产化均在加速导入。感谢关注。</p> <p>Q4：您好，刻蚀、薄膜沉积属于晶圆制造核心工艺设备，受益于逻辑、存储制程迭代和先进封装扩产，未来三年行业需求会保持中长期稳健增长。作为国内平台型公司，北方华创刻蚀、沉积产品线布局完整、客户覆盖全面，中长期收入增速有望持续跑赢行业平</p>
----------------------	--

均增速。感谢关注。

Q5: 您好, 2025年四季度毛利率阶段性承压, 主要是新品验证投入、产品结构及阶段性交付节奏影响。进入2026年, 随着高端工艺设备收入占比提升, 规模效应持续释放, 内部供应链降本及产品结构优化, 毛利率有望稳定。中长期看, 公司会通过高端产品放量、核心零部件本土化、产能与交付效率提升, 稳固并优化盈利水平。感谢关注。

Q6: 您好, 2026-2027年公司仍将维持高强度研发投入, 研发投入占营收比重将保持在合理高位区间, 持续夯实技术壁垒。研发重点主要集中在: 逻辑制程迭代设备、3D NAND及DRAM先进工艺设备、HBM与混合键合等先进封装设备等。感谢关注。

Q7: 您好, 市场传闻说法并不属实。公司始终坚持技术价值导向、市场化理性定价, 整体毛利保持平稳。感谢关注。

3.请问特朗普访华对国内半导体制造业的影响?

答: 您好, 公司对国际形势保持密切关注。谢谢。

4.公司2025年研发费用增速高于营收增速。请问目前在手的重点新设备, 通过客户端验证并进入批量订单的预期时间点大致是什么时候? 管理层判断其放量节奏会在2026年下半年还是2027年? 研发费用率何时能出现拐点?

答: 您好, 公司研发投入主要集中在逻辑制程迭代设备、3D NAND及DRAM先进工艺设备、HBM与混合键合等先进封装设备等, 预计2-3年后会逐步形成订单并实现销售收入。未来2-3年, 公司研发投入占营收比重将持续保持在合理区间。感谢关注!

5.请问公司年度分红派送计划如何、何时能够公布?

答: 您好, 公司2025年度利润分配方案为: 向全体股东每10股派发现金红利7.62元(含税)。该方案已于2026年5月11日经公司股东会审议通过, 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》, 本次现金红利派发预计于2026年7月实施。感谢关注。

6.目前在手订单总量充足吗?

答: 您好, 公司目前在手订单充足, 继续保持良好趋势。感谢关注!

7.请问公司目前产能利用率如何, 客户订单的情况怎么样?

答: 您好, 公司北京亦庄生产基地产能充足, 产能利用率与市场需求动态匹配。目前公司在手订单充足, 继续保持良好趋势。感

	<p>谢关注！</p> <p>8.公司未来资本开支计划是怎样的？重点投向哪些领域？</p> <p>答：您好，公司近几年资本开支主要聚焦研发投入，投入方向包括集成电路刻蚀、薄膜、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺设备，以及真空新能源设备等。感谢关注！</p> <p>9.关键零部件国产化推进情况怎么样了？</p> <p>答：您好，公司重视零部件国产化推进工作，随着零部件本地化供应能力快速提升，公司国产零部件采购比例也在逐年增长。感谢关注！</p> <p>10.请问高端半导体设备研发进度如何？</p> <p>答：您好，公司以满足客户需求为导向，研发的各类集成电路装备已广泛应用于国内存储、逻辑等领域的多个技术代。感谢关注！</p> <p>11.结合一季度情况，请问管理层对于今年全年经营有何预测？</p> <p>答：您好，公司2026年第一季度营收103.23亿元，同比增加25.80%，归母净利润16.35亿元，同比增加3.42%。公司预计全年经营状况仍将保持良好趋势。感谢关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年5月15日</p>